

证券代码：688516

证券简称：奥特维

无锡奥特维科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	投资者
时间	2024年12月20日
地点	无锡松瓷机电有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书周永秀女士、松瓷机电总经理华焱先生、松瓷机电高级销售总监姚彬先生、证券部陶敏燕、张秋仪、缪子健
投资者关系活动主要内容	
	<p>Q：公司的半导体级的单晶炉设备拿到了海外订单却没有国内的订单，是不是公司的设备还不够成熟？</p> <p>A：不是。从技术储备角度，松瓷具备生产半导体级单晶炉设备的能力，但需要在客户端进行试用验证的机会。先拿到海外订单的原因为海外客户认为中国设备的性价比较高，且松瓷的设备具有可实现定制化开发、高品质服务和技术快速迭代的特点，所以松瓷率先收获了海外客户的半导体级单晶炉设备订单。因松瓷的设备已得到海外客户的认可，在国内客户端的接受度逐步提升。目前松瓷已与国内客户合作进行技术研发，未来相关设备将发往客户端验证。</p> <p>Q：公司如何看待超导磁场工艺对降氧的影响？是否有相关的技术储备？</p> <p>A：超导磁场降氧工艺相较于常规降氧会更大幅度降低含氧量，但主要面临超导磁场成本较高的压力。松瓷的常规降氧主要通过软控系统优化和部分核心部件的改造推动整体工艺的提 升，可以以较低的成本实现含氧量的降低，满足客户需求。松瓷持续关注超导磁场工艺的变化，已有相应的技术储备。</p> <p>Q：现阶段公司半导体领域的进展情况如何？</p> <p>A：受益于半导体封测产业链的回暖带来的需求增加，公司铝线键合机和AOI设备等产品在客户端试用后获得的积极反馈，已收获批量订单，有望完成年初制定的半导体设备新签订单的目标。划片机和装片机已在客户端进行验证；CMP设备处于内部调试阶段，预计25年发往客户端验证。</p> <p>Q：公司如何看待叠栅、铜浆料等新技术带来的影响？</p> <p>A：公司对叠栅技术和铜浆料高度关注，叠栅技术在降本方面有良好的表现，但目前工艺难度较大；铜浆料能否替代银浆料也存在较大的不确定性，两者均需要时间验证。公司将持续跟踪所有的新技术路线，保证公司技术的先进性与竞争力。</p>

日期	2024 年 12 月 28 日
----	------------------